

高速氨基磺酸镍

1. 特点

- 尤其适用于卷镀式生产线（高速电镀）。
- 可用于挂镀及滚镀（只须改变操作参数）。
- 可用于连接器及引线框的高速镀镍工艺。
- 可产生延展性非常高及内应力低的镍镀层。
- 可选择哑光、半光及光亮镀层。
- 可用于氨基磺酸镍及硫酸镍的系统。
- 添加剂可使镀层光亮，延展性高，孔隙率低及少许填平作用。
- 添加剂能将镀层硬度提高至 550Hv。
- 可用传统方法分析镀液内添加剂的含量。
- 可选择镀层性质：
 - a) 半光 / 哑光镀层：最低内应力。
 - b) 光亮镀层：低内应力，最低孔隙率，高硬度

2. 镀液组成及操作条件

原料及操作条件	范围	标准(建议开缸份量)
高速氨基磺酸镍 HS 基础剂 (Nickel Sulphamate HS Base)	350 - 600 毫升/升	500 毫升/升
氯化镍 (NiCl ₂ · 6H ₂ O)	5.7 - 14 克/升	10 克/升
硼酸 (H ₃ BO ₃)	30 - 55 克/升	50 克/升
金属镍总量	65 - 105 克/升	90 克/升
高速氨基磺酸镍 HS 添加剂	4 - 10 毫升/升	5 - 6毫升/升
高速氨基磺酸镍 HS 湿润剂	0 - 5 毫升/升	2 - 4毫升/升
温度	45 - 70 ° C	60 ° C
pH	3.8 - 4.5	4.0
电流密度	10 - 12 A/平方分米	10 -40 A/平方分米

如需继续阅读或下载其他技术参数内容，欢迎扫码联系获取更多.....

